

DI Corporation

Investor Relations

August 2022



Disclaimer

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국 기업회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents

I

Corporate Overview

II

Business Area

III

Industrial Prospect

IV

New Business



Corporate Overview

1. 회 사 소 개
2. 경 영 실 적
3. 수 주 잔 고
4. 배 당 정 책



(주) 디 아 이

대표이사	박 원 호 회 장 조 윤 형 부 사 장
설 립 일	1961년 3월 16일 (1996년 7월 31일 상장)
임직원수	194명 ('22.6월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	17,248,392,500 원
발행주식수	31,496,785 주
소 재 지	본사 : 서울시 강남구 논현로 703 디아이B/D 공장 : 경기도 화성시 삼성1로 3길 32 (동탄사업장)
홈페이지	www.di.co.kr

(주) 디지털프론티어 (*)

대표이사	오 성 구 사 장
설 립 일	2007년 1월 31일
임직원수	61명 ('22.6월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	100,000,000 원
발행주식수	200,000 주
소 재 지	본사/공장 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9 엠타워지식산업센터 1301호
홈페이지	www.dfinc.co.kr

(*) 주요종속회사

(주) 디 아 이

2021.01	차세대 Burn-In Tester 양산기 납품 개시
2017.08	Burn-In Tester 2,000대 출하 달성
2014.02	Logic Burn-In Tester 양산기 납품
2013.05	Multi Flexibility Tester 양산기 납품
2010.12	Burn-In Tester 400호기 수출성과 달성
2007.11	제44회 무역의 날 5,000만불 수출탑 수상
2007.08	D.I China 설립 (소주 사무소)
2006.06	Burn-In Tester 세계 일류상품 선정
2006.02	'전자수출 1,000억 달러 달성' 기념 산업자원부 장관 공로패 수상
2005.11	제42회 무역의 날 2,000만불 수출탑 수상
2005.10	D.I Taiwan 설립 (신주 지사)
2005.09	제1회 대한민국반도체기술대상 최첨단기술상(국무총리상) 수상
2003.02	D.I Japan 설립 (동경 현지법인)
1996.07	기업공개 (거래소 상장)
1996.04	주식회사 디아이로 사명변경
1988.08	R&D Center 설립
1955.06	동일교역 설립

(주) 디지털프론티어 (*)

2021.01	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9로 본점 이전
2019.04	SK하이닉스 기술혁신기업 선정
2018.04	ISO9001 품질경영시스템, ISO14001 환경경영시스템 인증
2017.09	고속 웨이퍼 테스터 (DF-8600) 양산기 납품 개시
2017.08	고속 패키지 번인테스터 (DF-2200) 양산기 납품 개시
2014.03	경기도 성실납세자 선정
2012.05	(주)디아이로 최대주주 변경
2008.08	반도체 검사장치 특허등록 (특허 제10-0856079호)
2008.03	기업부설연구소 설립 인가 (한국산업기술진흥협회)
2007.05	PTBI FOS-8400 발주서 수령 (구매 금액 : 49억원)
2007.04	PTBI FOS-8400 개발 장비 납품 완료
2007.01	(주)디지털프론티어 설립

(*) 주요종속회사

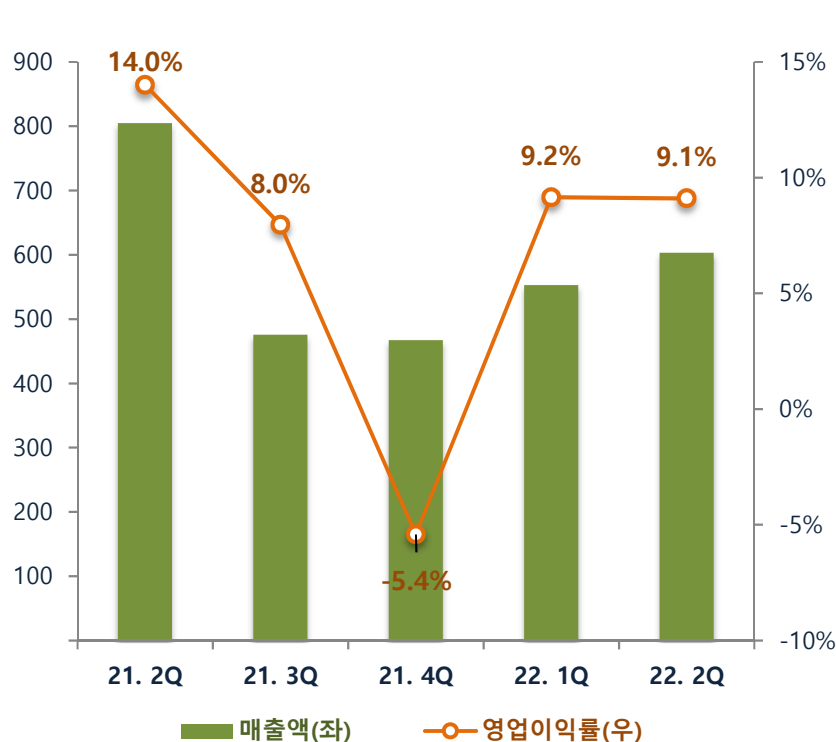
2-1. 최근 분기 경영실적

고객사 투자 본격 재개, 2개 분기 연속 성장

· '22, 전년도 대비 분기별 고른 실적 유지하며 완만한 성장세

▷ 매출액: 603억 → 반도체장비 사업부문 호실적 지속, QoQ +9.2% 달성

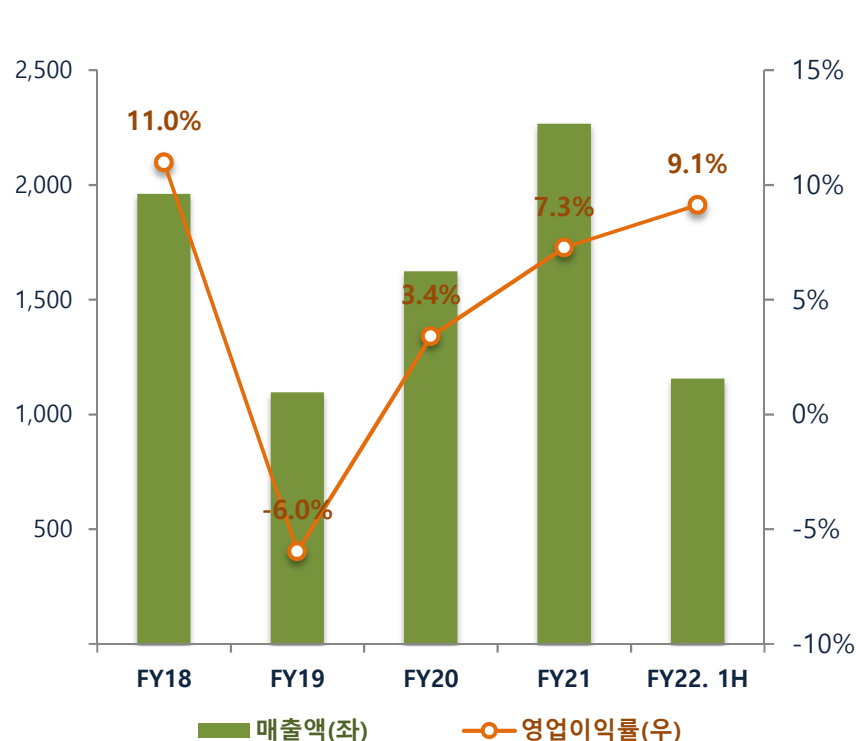
▷ 영업익: 55억 → 반도체/2차전지장비 등 고부가 제품 판매 호조로 9%대 OPM 유지



	21.2Q	21.3Q	21.4Q	22.1Q	22.2Q
매 출 액	805	475	467	552	603
반도체 장비	828	438	315	487	538
전 자 부 품	30	29	29	38	41
2 차 전 지	-	-	62	22	38
기 타	59	57	78	46	45
연 결 조 정	-112	-49	-17	-41	-59
영 업 이 익	113	38	-25	51	55

'21 DDR5 선제 투자 개시, '22 메모리 투자 기조 지속

- '21 DDR5 선제 투자 개시되며 사상 최대 매출액 및 전년비 3배 영업이익 달성
- '22 주요 고객사 DDR5 및 고단 NAND 장비투자 재개하며 호실적 지속 中



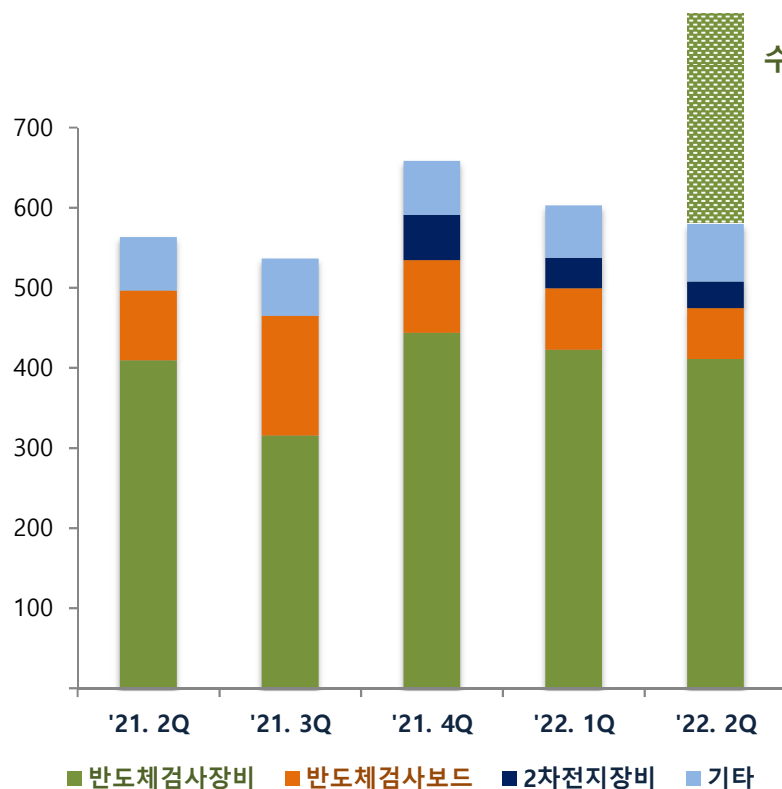
(단위: 억원)

	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22.1H
매 출 액	1,960	1,095	1,623	2,266	1,156
반도체 장비	1,860	875	1,382	2,105	1,025
전 자 부 품	200	174	149	118	78
2 차 전 지	-	-	-	62	60
기 타	65	93	201	239	92
연 결 조 정	-165	-47	-109	-259	-100
영 업 이 익	215	-65	55	165	105

3. 수주잔고

6~7월 대규모 수주로 하반기 실적 확보

- 반기말 수주잔고 580억 및 7월중 255억 추가 수주, 누적 수주잔고 835억
- 높은 수주잔고 유지 및 추가 수주 확보로 하반기에도 호실적 지속 전망



(단위: 억원)

부 문	21.2Q	21.3Q	21.4Q	22.1Q	22.2Q
반도체검사장비	409	315	444	422	411
반도체검사보드	87	150	91	77	64
2차전지장비	-	-	56	38	33
기 타	67	72	67	66	72
합 계	563	537	658	603	580

'8년 연속 현금배당 실시'

· 주주가치 제고 · 장기투자 유도를 위한 지속적 배당 정책 실시

※ 과거 배당이력

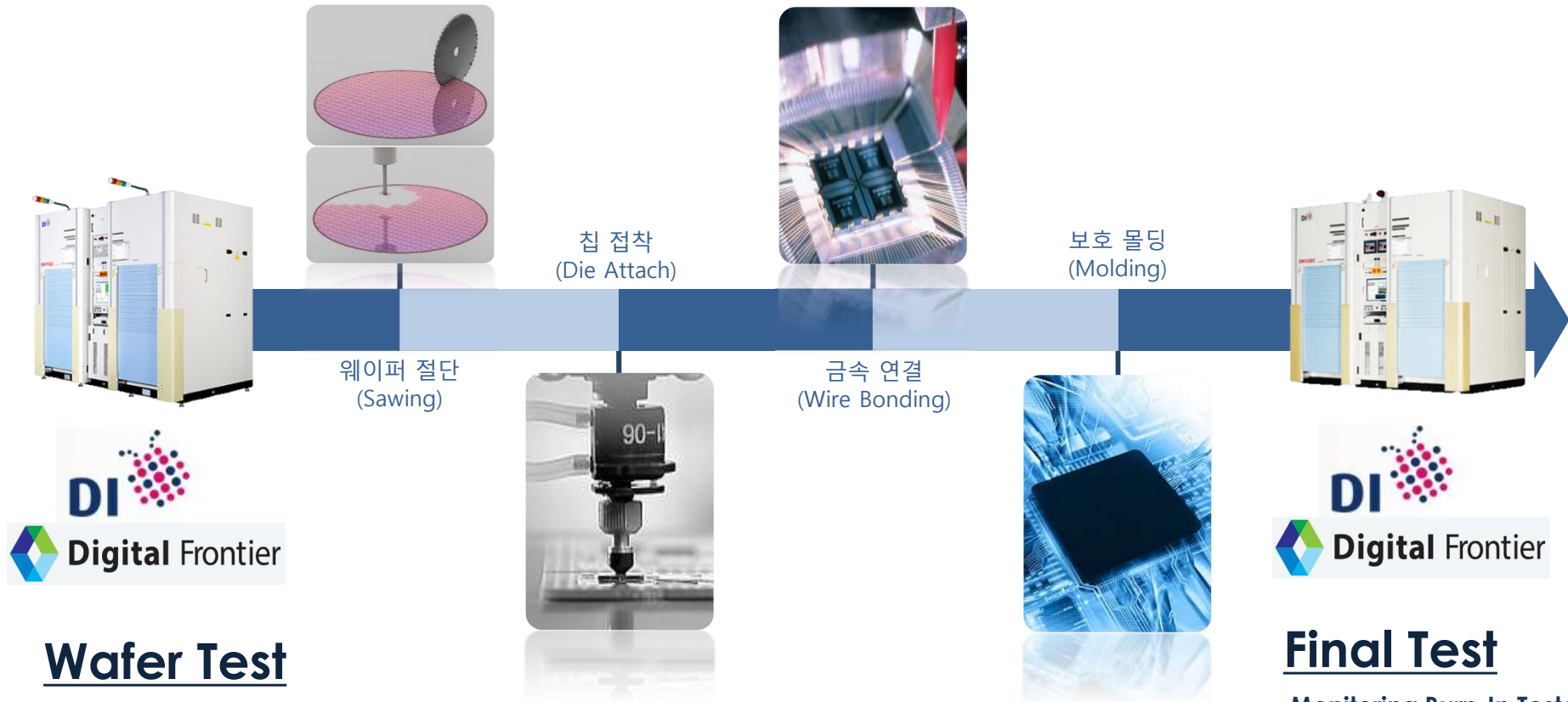
사업연도	주당 배당금	액면 배당률	시가 배당률	배당성향
2021년	200원	40%	2.2%	33.8%
2020년	100원	20%	2.3%	47.5%
2019년	50원	10%	1.6%	221.4%
2018년	50원	10%	1.4%	13.8%
2017년	100원	20%	2.0%	15.7%
2016년	50원	10%	1.1%	142.9%
2015년	50원	10%	0.8%	101.3%
2014년	75원	15%	1.1%	71.6%
연속배당 횟수		평균 배당수익률		
분기(중간)배당	결산배당	최근3년	최근5년	최근8년
-	8회	2.0%	1.9%	1.6%



Business Area

1. 사 업 분 야
2. 제 품 현 황
3. 고 객 사

반도체 후공정 (Back-End)



- 전(前) / 후(後) 공정 Test 제품군 보유
- 장비와 보드의 Product Mix

- High Speed-Multi Tester 시장 진입
- Non-Memory Tester 영역으로 확장 中

Wafer Tester Group



Wafer Memory Tester



Wafer Level Burn-In Tester

Logic Tester Group



Logic Burn-In Tester



LED Burn-In Tester

Package Tester Group



Monitoring Burn-In Tester
(Domestic)

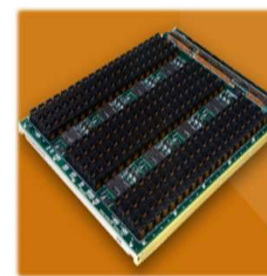


Test Burn-In Tester
(Overseas)

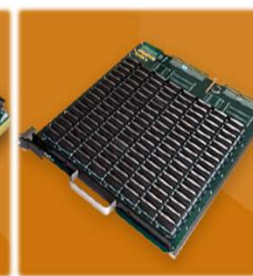


Multi Flexible Tester
(High Speed)

Boards Group



Memory
Burn-In Board



Logic
Burn-In Board



Wafer Mother Board

메모리 전공정 검사장비



- Wafer 단계에서의 성능 Test를 통한 수율 개선
 - Device: SDRAM, DRAM, NAND Flash 外
- SKH - NAND Wafer Memory Tester 공급 中
 - 기존 일본 A社 장비의 독점 영역을 침투 中
- 고객사의 국산화 정책으로
'적용범위 확장' 및 '점유율 확대' 기대

메모리 후공정 검사장비



Monitoring Burn-In Tester



Multi Flexible Tester
(High Speed)

- Package 공정 후 Cell 단위 신뢰성 Test 수행
 - Device: SDRAM, DDR, GDDR, NAND Flash
LPDDR, MCP 外
- 고속(High Speed) Burn-In 장비 양산 공급 中
- SEC - DRAM Burn-In 장비 1st 벤더 공급 中
NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中
- SKH - DRAM Burn-In 장비 2nd 벤더 공급 中
NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中

차세대 메모리 후공정 검사장비



- 고용량 · 고성능의 차세대 반도체 신뢰성 Test 장비
 - Device: DDR4, GDDR6, LPDDR5, DDR5 外
- DDR5 차세대 Burn-In Tester 시장 선점 및 양산기 납품 개시 ('21. 1월~)
- '21 SEC向 대규모 수주 및 현재 1st 벤더 공급 中
- '22 신규 CPU 플랫폼 출시에 따른 DDR5 전환을 가속화되며 지속적인 장비 공급 기대

비메모리 검사장비



Logic Burn-In Tester

- Endurance Test를 제공하는 고성능 장비
 - Device: DDI, SoC, Automotive, CIS 外
- 중화권 비메모리 OSAT업체에 공급 中
- SEC向 Logic Burn-In Tester 공급 中
 - 중장기 국산화 Potential

반도체 검사보드



Memory Burn-In Board



Wafer Mother Board

- 고객 Needs에 따라 다양한 설계 및 테스트 제공
 - Device: DDR, LPDDR, GDDR, NAND Flash, Logic 外
- SEC/SKH/해외 OSAT업체 등 다양한 고객사 확보

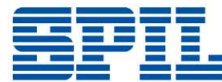
Memory Tester

DomesticOverseas

China



Taiwan



Powerchip

WALTON

Japan



Brazil



Non-Memory Tester

DomesticOverseas

ememory

Qualcomm

ESWIN

Boards

DomesticOverseas

ememory

winbond
We Deliver

RENESAS



Industrial Prospect

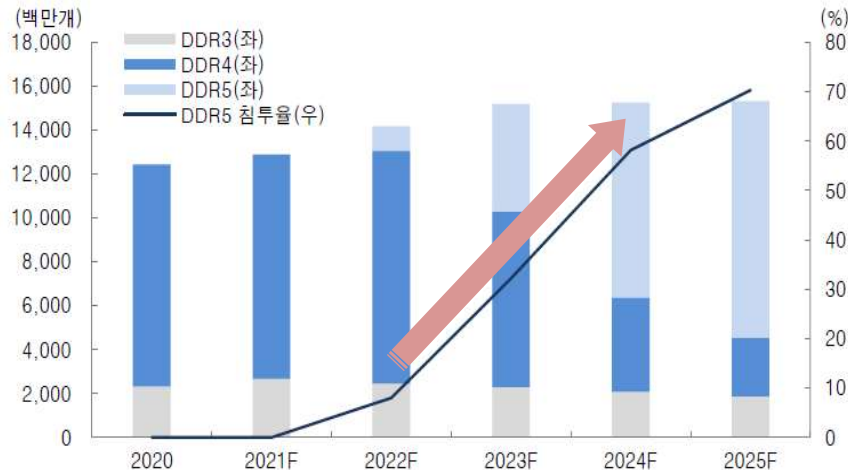
1. D R A M

2. N A N D

신규 플랫폼 출시에 따른 DDR5 침투 본격화

- Intel · AMD는 '22년중 DDR5 DRAM이 탑재되는 Server용 차세대 CPU 출시 예정
 - ▷ Intel : Sapphire Rapids (Server) → '22.2Q 초도 물량 출하 시작
 - ▷ AMD : Genoa (Server) → '22.3Q 출시 예정
- DDR5 침투 효과 및 고객사의 초격차 전략으로 차세대 검사장비 수혜 · 구조적 성장 전망

[DDR5 침투율 전망]



자료: Omdia, 대신증권 리서치센터

[서버용 Processor 스펙]

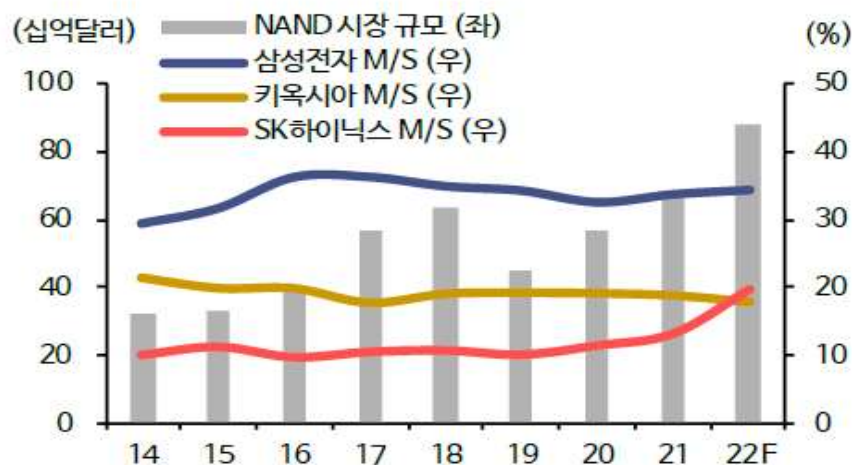
업체명 코드명	Intel		AMD	
	Ice Lake	Sapphire Rapids	Milan	Genoa
출시날짜	1Q21	2Q22	1Q21	3Q22
Fabrication Node	10nm	10nm	7nm	5nm
Microarchitecture	Sunny Cove	Golden Cove	Zen 3	Zen 4
Max Core 개수	40	40	64	96
Socket	LGA4189	LGA4677	LGA4094	LGA6096
Memory Support	DDR4	DDR5	DDR4	DDR5
Pcie Gen	PCIe 4.0	PCIe 5.0	128 Gen 4	128 Gen 5
Processor 세대	3세대	4세대	3세대	4세대

자료: 언론 자료, 신한금융투자

고단화 NAND 시장 선점 경쟁 심화

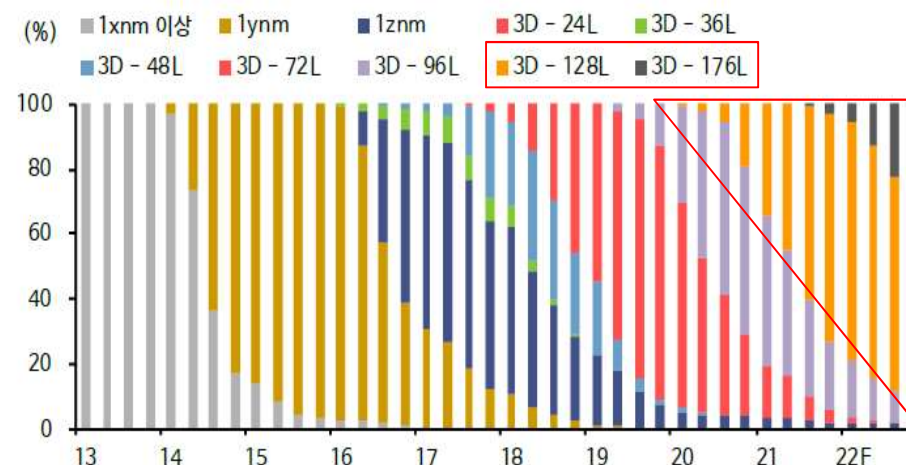
- SK하이닉스의 Intel NAND 사업 인수로 Enterprise SSD M/S 확대 기대
- 고단 NAND 양산 · 수율 확보 및 시장 선점을 위한 NAND 장비 투자 재개 전망

[NAND 시장 순위 및 M/S]



자료: 신한금융투자 추정

[SKH 3D NAND 단수 비중 추이]



자료: DRAMeXchange, 신한금융투자 추정

IV **New Business**

디아이, 2차전지 장비 신규사업 진출

- 新 성장산업인 2차전지 시장으로의 신규사업 진출
- 반도체 장비사업에서 축적된 노하우를 활용하여 2차전지 장비사업에 대한 시너지 창출
- 회사의 중장기 미래 성장동력으로 육성할 계획

[회 사 개 요]

회 사 명	(주)디아이비
대표이사	반 지 혁
주요사업	2차전지 공정자동화 장비 제조업
설 립 일	2021년 6월 28일
자 본 금	1,000,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	51.0%
관 계	연결대상 종속회사

회 사 명	(주)브이텐시스템
대표이사	박 재 연
주요사업	2차전지 머신비전시스템 SW/검사장비 제조업
취 득 일	2021년 10월 28일
자 본 금	1,000,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	60.0%
관 계	연결대상 종속회사

회 사 명	(주)프로텍코퍼레이션
대표이사	이 근 종
주요사업	2차전지 비전검사장비 제조업
취 득 일	2022년 3월 30일
자 본 금	175,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	57.1%
관 계	연결대상 종속회사



서울시 강남구 논현로703 | 02-546-5501 | www.di.co.kr